

基板剛性が必要とされる薄板PKG基板・ コアレス基板にソルダーレジストで剛性付与

Adding stiffness by solder resist for thin substrate / coreless substrate

02

アルカリ現像型ICパッケージ基板用高剛性ドライフィルム ソルダーレジスト PSR-800 AUS SR3

Photo-imageable High Stiffness Dry film Solder Resist for IC Substrate

特 長 Features

■ 高弾性率/高剛性

High Modulus & Stiffness

■ 低CTE/高Tg

Low CTE/High Tg

■ 高強度

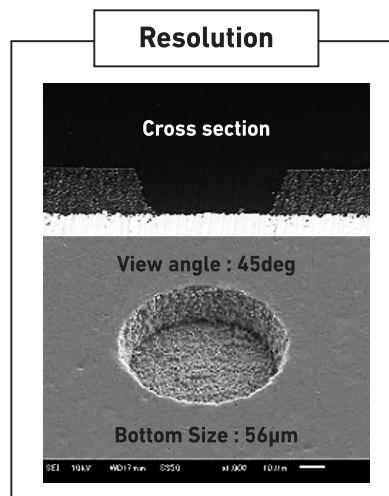
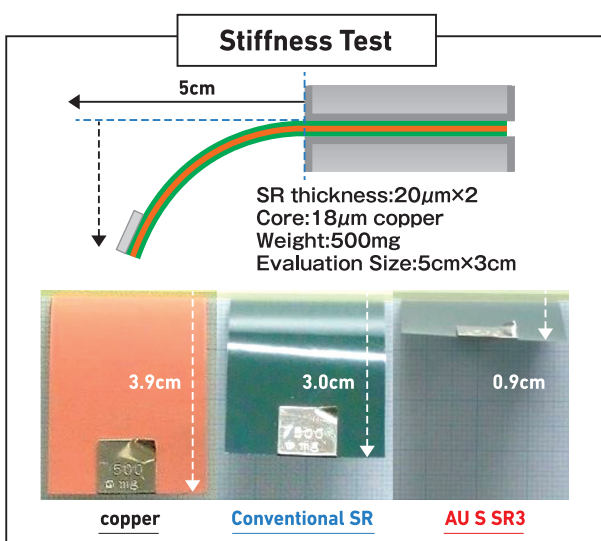
High Strength

■ ドライフィルムタイプ

Dry film type

特 性 Properties

ガラス転移点Tg *TMA method	150-160°C
線膨張係数 CTE (α_1)	15-20 ppm
弾性率 Young's modulus *DMA method	12.5-13.5 Gpa
破壊強度 Tensile strength	90-100 Mpa
破壊伸び率 Elongation	2.0-3.0%
HAST耐性 (130°C/85%RH, 5V,L/S=12/13)	300h Pass



用 途 Application

■ 薄板PKG基板

For Thin Substrate

■ コアレス基板

For Coreless Substrate